科学研究費助成事業

今和 5 年 6 月 1 9 日現在

研究成果報告書

機関番号: 22701 研究種目: 基盤研究(C)(一般) 研究期間: 2020~2022 課題番号: 20K05330 研究課題名(和文)菊池パターンを利用した表面の構造解析手法の確立

研究課題名(英文)Development of surface structure analysis method using Kikuchi pattern

研究代表者

重田 諭吉(Shigeta, Yukichi)

横浜市立大学・生命ナノシステム科学研究科(八景キャンパス)・客員教授

研究者番号:70106293

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000円

研究成果の概要(和文):本研究は、表面構造の解析法として菊池パターンを用いる新たな測定手法の確立を目 的として実施した。菊池パターンは非弾性散乱により形成された二次的入射波が種々の方向から入射し、各格子 面からの回折波により直線状または曲線状の像を形成したものであるため、入射条件を変化させて測定して得ら れる多くの情報を含んでいる。種々の回折条件における情報は非弾性散乱確率を知ることで1枚の菊池パターン から求めることができる。そこで、菊池パターンの強度と動力学的な回折強度計算の結果を比較したところ、表 面波共鳴条件が起こる菊池エンベロープで表面プラズモンの散乱断面積が著しく増大することを見出した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 結晶表面の構造は、結晶の周期性が断ち切られた表面があるために結晶内部とは異なった構造を形成してい る。そして、結晶表面の性質は、その構造と密接に関係しているために、表面では特有の電子的・機械的物性が 現れる。特に、半導体表面ではその特異な物性により、新たな機能を持った素子が創造できる可能性がある。そ のためには、表面構造を正確に知る必要があるが、従来の電子線回折実験では多くの入射条件による測定結果が 必要となる。そこで、一つの入射条件で得られた回折パターンのバックグラウンドである菊池パターンから構造 必要となる。そこで、一つの人類 解析する手法の確立を目指した。

研究成果の概要(英文): The purpose of this study is to establish a new measurement method using the Kikuchi pattern as an analysis method for the surface structure. In the Kikuchi pattern, secondary incident waves created by inelastic scattering are incident from various directions, and diffracted waves from each lattice plane form linear or curved images, so it contains a lot of information at various incident conditions. Therefore, the information under various diffraction conditions can be obtained from a single Kikuchi pattern by knowing the inelastic scattering probability. Then, we compared the intensity of the Kikuchi pattern and the result of intensity calculation based on the dynamical diffraction theory and found that the scattering cross-section of the surface plasmon remarkably increases in the Kikuchi envelope where the surface wave resonance condition occurs.

研究分野:表面科学

キーワード: 表面構造 RHEED 菊池パターン 構造解析 非弾性散乱

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

2版

1. 研究開始当初の背景

表面構造の解析に有力な手法として、反射高速電子回折(RHEED)法がある。近年、結晶表 面や薄膜の構造解析に高い精度が求められ、詳細な構造解析の手法として、ワイゼンベルグ RHEED法のように入射方位を細かく変化させて撮影した膨大な数の回折点の強度をフーリエ変 換し、詳細な表面構造を解析する手法が開発され成果を収めている[1]。しかし、入射方位を超高 真空中で正確に変化させるためには、高精度の試料台と回転機構が不可欠と成り、手軽に回折強 度のデータを収集することは非常に難しい。これに対し、収束電子線を用いた局所領域の高精度 な歪測定法があり、10⁻⁴の歪量の測定が報告されている[2-6]。そこで、薄膜・表面の高精度解析 が可能な簡便な手法を新たに考えた。

図 1(a)に代表的な Si(111) 7X7 表面 の回折像を示す。RHEED 像には、回 折スポットの他に直線状の菊池線や 放物線状の菊池エンベロープが観察 される。この菊池パターンは、以下の ような過程によって生成される。1) 入射電子線がフォノンやプラズモン といった素励起を励起することによ り、エネルギーと運動量の変化を伴 う非弾性散乱を受ける(図1(b))。こ の非弾性散乱により入射電子線は、 数 meV~十数 eV のエネルギーを失 うが、高速電子線にとって 0.1%以下 の変化である。一方、運動量は逆格子 点間隔を超える程の量となるため、 種々の方向に二次的入射波が形成さ れる。2)この二次的入射波の内、図 1(c)に示すように、ある逆格子点Nに 対する回折条件を満たす二次的入射 波は、楕円で示す位置から入射する 波であり、これらは楕円上から N 点



に向かう回折波を励起する。これらの回折波はスクリーン上では、ほぼ直線として観察され菊池 線と呼ばれている。また、菊池エンベロープ[7]の形成は、図 2(a)に示すように、まず、二次的入 射波のエバルト球が表面の二次元格子による逆格子ロッドに接する時に、表面に平行な回折波 (表面波)が励起される。この表面波は、結晶外へ出られないため、その一部が鏡面反射波に乗 り移り、鏡面反射波の強度が著しく増大する(表面波共鳴(SWR)現象)。m次の逆格子ロッド に対して、SWR 条件を満たす二次的入射波は、図 2(b)に示すように L(1)、L(2)、L(3)の方向から 入射した波であり、それぞれの鏡面反射波の強度が増大する。その結果、軌跡はスクリーン上で、 S(1)、S(2)、S(3)に沿った放物線状の輝線として観測される。これが菊池エンベロープであり、そ の強度分布は表面二次元格子の逆格子ロッドに対する情報を含んでいるので、表面の構造解析 をする場合により詳細な表面領域の情報を与えてくれることが期待された。 このように、菊池パタ ーンは1つの格子面に 種々の方向から入射した 二次的入射波の内、回折 条件を満たした波により 形成されるため、直線状 または曲線状に像を形成 する。図3に示すように、 動理学的回折理論に基づ く00スポットのRHEED ロッキング曲線をすべて の方位角について計算し た結果、その二次元像が 菊池線や菊池エンベロー



プの現れる位置を再現することが分かった[8]。したがって、その二次元像に非弾性散乱の散乱 断面積を畳み込み積分することで、菊池パターンをシミュレーションすることが可能であると 考えた。この解析過程で表面プラズモン(SP)や固体プラズモン(BP)といった素励起の散乱断面積 の違いなども明らかにでき、新たな知見を得ることも期待された。

2. 研究の目的

前述の様に菊池パターンの強度分布は、多くの入射条件における回折波の情報を含んでおり、 実験的に入射条件を変化させて測定して得られた結果と同等の情報が1 枚の回折像の中に含ま れている。そこで、実験的に非弾性散乱確率を求めることで、非弾性確率を組み込んだ菊池パタ ーンのシミュレーションができ、1 枚の回折パターンから詳細な表面構造解析が可能となる。た だし、菊池パターンは、種々の素励起の非弾性散乱電子により形成されるので、各素励起に対す る散乱断面積を知る必要がある。そのために本研究では、既存の RHEED 装置[9]のスクリーン手 前に、堀尾らの研究[10]で実績のある阻止電位型のエネルギーフィルターをフランジマウント型 で作製・装着し、阻止電位を変化させたパターンから、各種素励起による非弾性散乱の強度分布 を測定する。その結果と動理学的回折理論に基づく RHEED 強度の二次元像[8]を比較すること で素励起による非弾性散乱の散乱断面積を実験的に測定することが、第一の目的である。

第二に、動理学的回折理論に基づく 00 スポットの RHEED ロッキング曲線をすべての方位角 について計算した結果に、非弾性散乱断面積を畳み込み積分することで、菊池パターンを再現す ることが可能か判断することである。この過程で SP や BP といった素励起の散乱断面積の違い なども明らかになり、新たな知見を得ることも期待される。

3. 研究の方法

(1) 菊池パターンのエネルギー分光

各種素励起による非弾性散乱の強度分布を測定するために、平面の3枚グリッドによるエネ ルギー阻止型のエネルギーフィルターを試料とスクリーンの間に設置し、菊池パターンのエネ ルギー分光をおこなった。阻止電位は、本研究費で購入した高精度高圧電源(負極性出力、HERR-20N1.5-LG)を用い3枚グリッドの中間の第2グリッドに阻止電位を印加し、ハイパスフィルタ ーとして機能させた。この高精度高圧電源の性能は、-15000Vの高電圧出力時に、リップル: 0.15V(10ppm)、安定度:0.75V(50ppm)と非常に安定であり、電圧制御に関しても 20kV まで1V 単位でデジタル制御できることが特徴である。これにより、-15000V前後の阻止電圧を1V単位 で制御でき、Si表面の非弾性散乱(SP: $\hbar\omega_{SP}$ =11eVおよびBP: $\hbar\omega_{BP}$ =17eV)によるエネルギー 損失ピークの識別が可能となる。

(2) 動力学的回折理論による菊池パターンの強度解析

菊池線や菊池エンベロープと言った菊池パターンを計算するために、動力学的な回折効果を 考慮した多波(~250波)の電子線回折強度の計算を行った。この鏡面反射強度の視射角依存性 (ロッキングカーブ)の方位角を少しずつ変えて計算すると、視射角と方位角の二次元の強度依 存性が得られる。この二次元パターンの示す輝線の位置は菊池線や菊池エンベロープの現れる 位置と一致することが分かっている[8]。この像は非弾性散乱による二次的入射波の強度がすべ て1として菊池パターンを描いたものに相当するので、非弾性散乱確率を仮定して強度分布に 畳み込み積分し二次元の強度分布を得る。次に二次電子放出によるバックグラウンドの視射角 および方位角の依存性を実験結果から求め、その依存性を二次元の強度分布に反映させた二次 元像を得る。この結果を実験で得られた菊池パターンと比較することで計算により菊池パター ンが再現できるか判定する。

4. 研究成果

(1) 菊池パターンのエネルギー分光

図4は、入射電子の加速電圧を12kV と し、[112]方位、視射角3.05°で入射したとき の回折パターン強度をエネルギーフィル ターを用いて分光し、微分処理したエネル ギー損失スペクトルを示す。この入射条件 では、菊池エンベロープの交差する点と鏡 面反射点が重なり、表面波が強く励起され る条件となっている。スペクトルは主に強 い SP ($\hbar\omega_{SP}$ = 11eV)の複数回励起に BP ($\hbar\omega_{BP}$ =17eV)の成分が加わっていることが 分かる。

同様な入射条件で、エネルギー分光はで きていないが、菊池エンベロープに沿った 非弾性散乱強度分布を解析した結果、図5a) と b)に示すように鏡面反射点の上側と下 側では散乱断面積σに違いがあり、それぞ れの成分をガウス分布として分離してみ ると図6(a)鏡面反射点の上側、およびb) 鏡面反射点の下側)に示すように、下側で は散乱ベクトルが 0.2~0.3Å⁻¹付近にピー クを持つ断面積が存在することが分かっ た。これは、SPの分散関係から予想される 断面積の変化と対応することから、SPの励 起確率が増大したものと判断した[11]。こ



の様に、表面波を同時に励起する入射条件の 菊池エンベロープに沿った反射位置では、SP の複数回励起が起こるため、非弾性散乱強度 は著しく増大するものと考えられる。

(2) 強度計算による裏付け

このことを裏付ける計算結果として、図7 に246波を考慮した RHEED 強度計算から得 られたロッキングカーブ強度の二次元分布 に1 種類の非弾性散乱断面積を畳み込み積 分した二次元パターンを示す。下図の視射角 が1.62°の場合、強度分布(回折スポット強 度および菊池パターン)は比較的よく実験結 果を説明できているが、表面波を同次に励起 する視射角が3.07°では鏡面反射点付近の 著しい強度の増大が説明できない。この条件 下では、表面プラズモンの励起確率が桁違い に高くなるためと考えられる。

したがって、表面波を励起する場合には表 面プラズモンの効果を取り入れることで、菊 池パターンの強度シミュレーションがより 正確に行えると言える。



参考文献

- [1] T. Abukawa, et al., Phys. Rev. Lett. 97, 245502 (2006).
- [2] K. Kobayashi, et. al., Extended Abstracts of the 19th Conference on Solid State Device Materials, Tokyo, Japan (1987), p. 323A
- [3] H. Brunner, G. Abstreiter, B. O. Kolbesen, and H. W. Meul, Appl. Surf. Sci. 39, 116 (1989).
- [4] K. Kimoto, K. Usami, H. Sakata, M. Tanaka, Jpn J. Appl. Phys. 32, L211 (1993).
- [5] J. Vanhellemont, et al., Appl. Surf. Sci. 63, 119 (1993).
- [6] A. Toda, N. Ikarashi, and H. Ono, J. Cryst. Growth 210, 341 (2000).
- [7] A. Ichimiya, K. Kambe, and G. Lehmpfuhl, J. Phys. Soc. Jpn. 49 (1980) 684.
- [8] Yuto Hagiwara and Yukichi Shigeta, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 114606 (2017).
- [9] Y. Fukaya, Y. Shigeta, and K. Maki, Phys. Rev. B61, 13000-13004 (2000).
- [10] Y. Horio and T. Hara: Jpn. J. Appl. Phys. 41, L 736 (2002).
- [11] Y. Shigeta, M. Higuchi, Y. Hagiwara, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 21, 211-217
- (2023). https://doi.org/10.1380/ejssnt.2023-014

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計3件(うち査読付論文 2件/うち国際共著 0件/うちオープンアクセス 1件)

1.著者名	4.巻
Ishii Chiaki、Shigeta Yukichi	709
2.論文標題	5 . 発行年
Structural changes due to reannealing of Ge thin films prepared by solid phase epitaxial growth	2020年
on Si (111) surface	
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Thin Solid Films	138007_1 ~ 8
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.tsf.2020.138007	有
「オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
重田 諭吉	⁶⁸
2.論文標題	5 . 発行年
半導体薄膜の固相エピタキシーにおける結晶化と再結晶化	2020年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
横浜市立大学論叢	37-60
掲載論文のD0I(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
なし	無
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
Shigeta Yukichi、Higuchi Morio、Hagiwara Yuto	21
2.論文標題	5 . 発行年
Influence of Surface Plasmon on Kikuchi Pattern in RHEED	2023年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
e-Journal of Surface Science and Nanotechnology	211-217
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1380/ejssnt.2023-014	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	-

〔学会発表〕 計1件(うち招待講演 0件/うち国際学会 1件) 1.発表者名

Yukichi Shigeta, Morio Higuchi and Yuto Hagiwara

2.発表標題

Influence of Inelastic Scattering Cross-Section on Kikuchi Pattern in RHEED

3 . 学会等名

The 22nd International Vacuum Congress: IVC-22(国際学会)

4.発表年 2022年

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

-

6	研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
--	---------------------------	-----------------------	----

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------